

Mit Lichtgeschwindigkeit zur perfekten Siebdruckschablone!

Mit diesem Anspruch entwickeln und produzieren wir in der Schweiz eine umfangreiche Palette von **Computer-to-Screen (CtS) Anlagen** unter dem Logo **SWISS CtS TECHNOLOGY**. Die aktuelle TEX-Serie ist bereits die **vierte Generation** von StencilMaster Direktbelichtungsanlagen.

Die aktuelle TEX-Serie ist in drei Grössen lieferbar:

TEX_S mit einer maximalen Siebrahmengrösse von H 1200 x B 1250 mm

TEX_L mit einer maximalen Siebrahmengrösse von H 1200 x B 1600 mm

TEX_XL mit einer maximalen Siebrahmengrösse von H 1500 x B 2000 mm

Die konventionelle Siebbelichtung ist durch die grosse Anzahl von Prozessschritten sehr aufwändig, teuer und fehleranfällig.

Die CtS Anlagen setzen neue Massstäbe und überzeugen mit diesen Vorteilen:

Höchste Reproduzierbarkeit dank **DIGITAL SCREEN MAKING**, Filmkosten und Handling entfallen, Verbesserung der Druckqualität, höhere Produktivität, grosse Flexibilität und tiefere Schablonenkosten.

UV-Lichtquelle: Leistungsstarke **LED_Q4 (Gen6)** oder **330W CPL UV-Lampe** für eine optimale Belichtung und Durchhärtung mit nahezu allen Direktemulsionen und auf allen Geweben. Als Variante kann auch eine **UV-LED DUO Lichtquelle** angeboten werden.

Optik von ZEISS: lichtstark, verzugsfrei, stabil und hoch präzise.

Verfügbare Auflösung: 1270 dpi, 1609 dpi (HR1)

OECU (Optical Engine Control Unit): Das Herzstück der neuen Generation. Diese Eigenentwicklung verbindet als Steuereinheit alle Prozesse für den Belichtungskopf. **DMD's (Digital Micromirror Device)** der neusten Generation werden ebenso angesteuert wie die hoch präzisen Horizontal- und Fokusachsen.

STPrint V.4: Die Bedienersoftware aus eigenem Haus erlaubt die zentrale Bedienung und Steuerung der STMANlagen – inkl. ganzer IN-LINE Anlagen von Grünig.

Grundkonstruktion: Diese Bauweise aus hochwertigem und massivem Stahl ist unerlässlich für eine hochwertige und präzise Direktbelichtung. Auf der Grundkonstruktion wird das Mehrachsensystem aufgebaut. Eine luftgelagerte Belichtungseinheit sorgt für vibrationsfreie Bewegungen und das einzigartige Antriebssystem arbeitet in horizontaler Richtung.

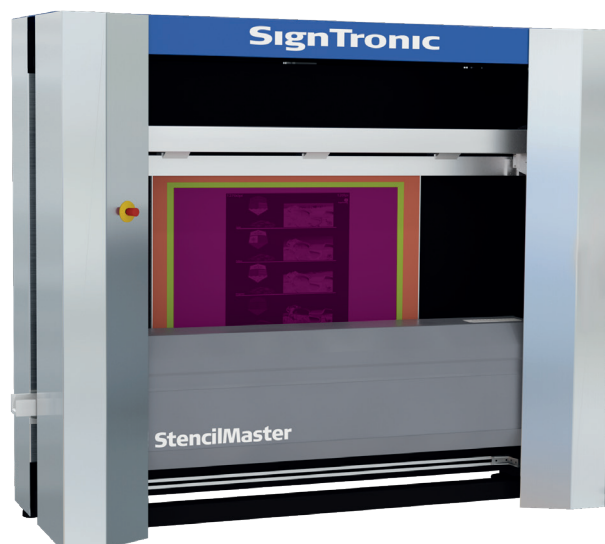
Bidirektionale Belichtung: Diese Standard-Arbeitsweise ist durch die Vor- und Rückwärtsbewegung sehr präzise und schnell.

Automatische Positionierung der Siebrahmen: Alle StencilMaster der TEX-Serie können von beiden Seiten be- und entladen werden. Der automatische Einzug sorgt für einfaches Handling, schnelle und genaue Positionierung als auch Fixierung in der Anlage.

Modular ausbaubar: Anlagenkonzept mit Anbindung aller Grünig IN-LINE Anlagen (Lade- und Entlademagazine, Entwicklungs-, Beschichtungs-, Abblas- und Trocknungsanlagen) möglich.

Option RICB (Remote Image Control Board):

Damit wird die Belichtungsqualität einfach überwacht und beibehalten. U.a. sind folgende Kontrollen und Messungen möglich: mechanische Grundeinstellung inklusive Fokussmessung, Lichtmessung des gesamten DMD.



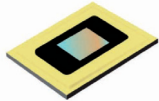
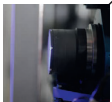
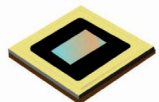
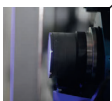
STM
TEX

StencilMaster[®]

Technische Spezifikationen

Technische Daten	STM-TEX_S	STM-TEX_L	STM-TEX_XL
Höhe	2035 mm	2035 mm	2324 mm
Breite	2400 mm	3040 mm	3040 mm
Tiefe	985 mm	985 mm	985 mm
Netto Gewicht	ca. 1350 kg	ca. 1480 kg	ca. 1620 kg
Max. Rahmenformat (H x B)	1200 x 1250 mm	1200 x 1600 mm	1500 x 2000 mm
Max. Belichtungsformat (H x B)	1050 x 1040 mm	1050 x 1600 mm	1350 x 1600 mm
Verfügbare Auflösung	1270 dpi, 1609 dpi (HR1)		
UV-Lichtquelle	LED_Q4 (Gen6), High power CPL 330 W oder UV-LED DUO (385 nm / 405 nm)		
Leistungsaufnahme	~ 1100 W		
Datenschnittstelle	Ethernet 1-Gbit		
Fernwartung	In Datenschnittstelle integriert (Internetverbindung notwendig)		
Betriebssystem	Windows 11		
Technische Anforderungen			
Spannungsversorgung	208-240 VAC / 50 Hz / 16A		
Druckluftanschluss	6 bar		
Druckluftverbrauch	max. 50 l/min		
Druckluftqualität	ISO 8573-1 4.4.4		
Raumbedingungen	Gelblicht, staubfrei, vibrationsfreier Boden		
Bodenbelastung	500 kg/m2		
Umgebungstemperatur	18 - 24° C		
Luftfeuchtigkeit	25 - 75 % (rF)		
Benötigtes Datenformat	1-bit TIFF		
Optionen			
Prozesskontrolle	RICB (Remote Image Control Board)		
Masterframe M	Aufnahme für mehrere kleine Siebrahmen		
Auflösung	1609 dpi (HR1)		
RIP Software	SignTronic ST.Rip		
Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB der Grünig-SignTronic AG			

MODULAR Cts CONCEPT

	UV-Lichtquelle	Technologie DMD	Zeiss Optik /Auflösung
UV-LED	Q4 365 / 385 / 395 / 405 nm 	XGA 0.7" – Discovery 4100 	1270 dpi  2400 dpi
	DUO 385 nm / 405 nm 		
UV-Lampe	CPL 350 – 450 nm 	1080p 0.95" – Discovery 4100 	1609 dpi  3040 dpi
	UHP 350 – 450 nm 		